



- ・表面実装部品は予め半田付けしてあります。
- ・赤枠で囲んだ部品が取り付けます。背の低い部品から取り付けます。
  - 1) 抵抗の線を曲げを取り付けます。足をカットします。
  - 2) 表面実装コンデンサ (std) の場合はここで装着します。  
オプションコンデンサは後でも構いません
  - 3) 半固定ボリュームを付けます。  
500Ω は右一杯に、100Ω は中央に矢印を合わせておきます。  
**特に500Ω はアイドル電流制御のため重要です。**
  - 4) FETを取り付けます。  
中央の足だけを最初に半田付けし、位置を調整してから他の足を半田付けすると綺麗にできます。  
**2SK246は必ずペア品を合わせてください。**
  - 5) POWERスイッチ、LED、ジャック、ボリュームを取り付けます。
- ・収納ケースを加工して基板を入れます (HPA v6-2マニュアルを参照)
- ・電池ケースを加工し、配線長さを調整して基板に配線します (同上参照)

## 【調整方法】

- ・**500Ωの半固定抵抗が右側一杯になっていることを確認してください。**
  - ・電池ケースに充電されたLi-ion電池を装着してください。
  - ・Powerスイッチを右に倒しLEDが明るく点灯すればOKです。
  - ・基板にかかる電圧をチェックしてください。  
GNDに対して**A端子が約4V**、同じく**B端子が約-4V**です。
  - ・アイドル電流の調整をします  
音量ボリュームを最小にしてください。  
10Ω抵抗の両端電圧(赤丸印の間)をデジタルテスターで計測します。  
最初は0mVになっているはずですが。  
この電圧を計測しながら、500Ω半固定抵抗を左側にゆっくりと回していきます。  
**あるところから急に電圧が発生します。**この電圧が**約100mVになるように合わせます。**  
この調整を左右chで行います。
  - ・DC調整をします  
100Ω半固定抵抗の矢印が真上くらいになっていることを確認してください。  
**△印とGND間の電圧をデジタルテスターで計測します。**  
この電圧が**±5mV未満**になるように100Ω半固定抵抗を左右に動かして調整します。
- \* 調整ができない場合は、90%以上どこかの半田付けが不良の場合が考えられます。  
部品の半田付けを行っている端子と基板ランド間の導通をチェックしてください。